

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2025-061

北京君正集成电路股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）根据总体规划，经第六届董事会第二次会议和 2024 年年度股东大会审议通过，将“车载 ISP 系列芯片的研发与产业化项目”变更为“3D DRAM 芯片的研发与产业化项目”，并由公司下属全资子公司芯成半导体（上海）有限公司承担。原承担“车载 ISP 系列芯片的研发与产业化项目”的公司全资子公司合肥君正科技有限公司将就“车载 ISP 系列芯片的研发与产业化项目”的剩余募集资金进行减资，由公司通过全资子公司北京矽成半导体有限公司（以下简称“北京矽成”）向承担“3D DRAM 芯片的研发与产业化项目”的芯成半导体（上海）有限公司进行增资。上述子公司将相应办理相关增资和减资事项的工商变更手续。

近日，北京矽成完成了工商变更登记手续，并取得了北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

名称：北京矽成半导体有限公司

统一社会信用代码：91110302318129402G

注册资本：54991.027243 万元

类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘强

成立日期：2014 年 11 月 02 日

住所：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 3 层 301-8

经营范围：设计、研发、委托加工超大规模集成电路半导体产品；软件开发；销售电子产品；技术开发、转让、服务；货物进出口、技术进出口、代理进

出口；投资与资产管理；投资管理；投资咨询。(该企业 2020 年 4 月 1 日前为外资企业，于 2020 年 4 月 1 日变更为内资企业；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十五日